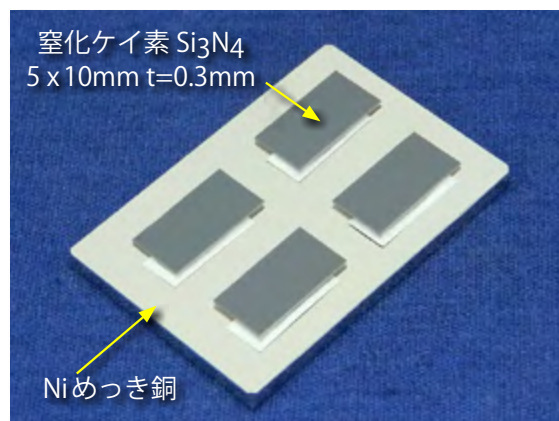




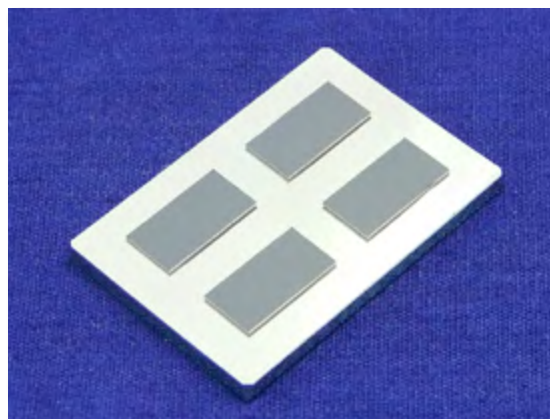
SoundBonding application



〈セラミックス基板とヒートシンクの
ダメージのない異材料間一括接合〉



接合前



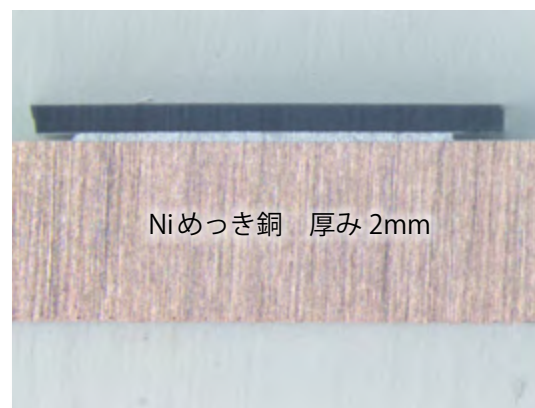
接合後



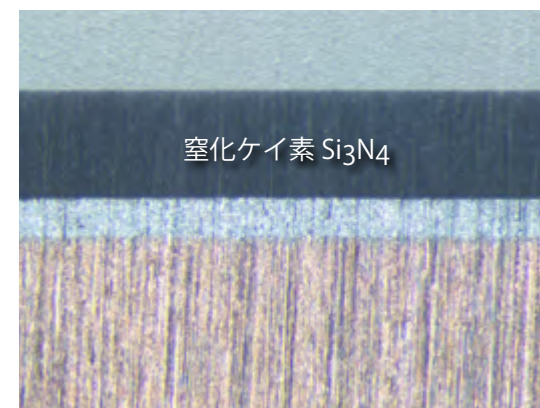
折り曲げて接合強度を確認



- ★窒化ケイ素基板とNiめっき銅製ヒートシンクの異材料間接合
- ★4個のセラミックス基板を一括同時接合
- ★ヒートショックテストクリア (-50 ~ 600°C)
- ★音エネルギーのみで接合
- ★大気中常温接合
- ★接合のエネルギー源は電気とエア
- ★デスクトップ接合



接合断面観察



接合部拡大

SoundPower[®]
Laboratory

ULTEX[®]

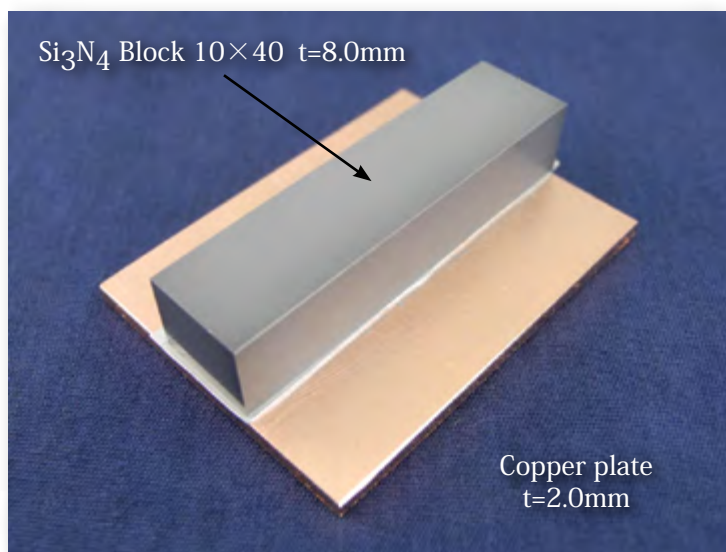


SoundBonding application

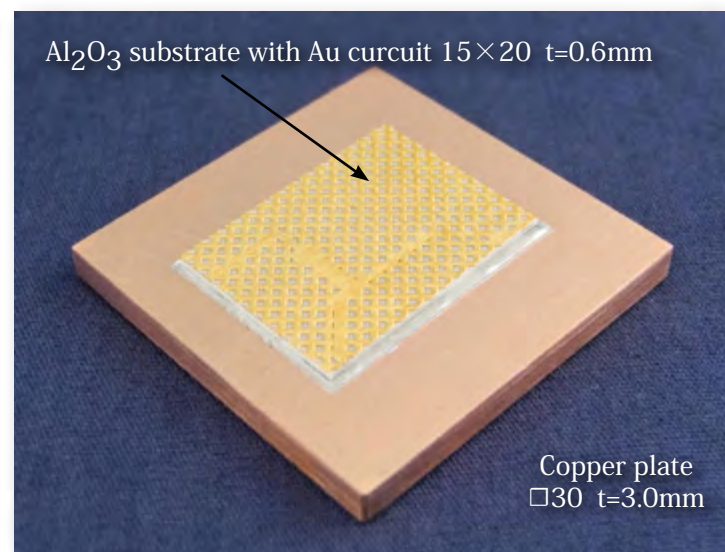


〈セラミックスの異材質間音波接合〉

大気中・常温・窒化ケイ素・アルミナ基板・銅板



★ [窒化ケイ素 & 銅板]



★ [アルミナ基板 & 銅板]

DM Bonding Different Materials Bonding

- ★異材料間の綺麗な接合
- ★音エネルギーのみで接合
- ★大気中常温接合
- ★接合のエネルギー源は電気とエア
- ★デスクトップ接合

SoundPower[®]
Laboratory

ULTEX[®]